**Produktbeschreibung:**
**Schnelle Details**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Herkunftsort | Guangdong China (Festland) | Markenname | O-Führung |
| Basismaterial | FR-4, Aluminium | Kupfer Dicke | 0.5oz-5oz |
| Mindest. Lochgröße | 0,2 mm | Mindest. Linienbreite | 0,2 mm |
| Oberflächenbearbeitung | Immersion Gold, OSP, bleifrei HASL | Plattendicke | 0,1-5mm |
| anwendbar auf | LED, Mobiltelefon, Klimaanlagen, Waschmaschinen | Charakter | Industrielle Steuerplatine |
| Zertifikate | ISO9001, UL, RoHS, SGS | Q / CTN | 10PCS-100PCS |
| Gewicht | 0,01 kg -5 kg | MOQ | 10 Stück |
| Modell-Nr | Power Bank Leiterplattenbestückung pcba Hersteller | Mindest. Zeilenabstand | 0,2 mm |
| Farbe | blau, rot, grün, schwarz | Preis | $ 0,1- $ 10 |
| Desigh-Typ | Kundenanforderung | Größe | 0,01 m 3 bis 10 m 3 |

Verpackung & Lieferung

| | |
|---|---|
| Verpackungsinformationen | 16 Jahre professionelle OEM Leiterplattenhersteller |
| Lieferdetails | 7-12days |

**Produktbeschreibung**

**16 Jahre professionelle OEM-Leiterplattenfertigung**

| Artikel | 2014 | | 2015 ~ 2016 | | 2017 ~ 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Volumen | Probe | Volumen | Probe | Volumen | Probe |
| Anzahl der Ebenen | 32 | 42 | 38 | 44 | 42 | 48 |
| Min Linie / Abstand (µm) | 50/50 | 40/45 | 40/45 | 40/40 | 35/40 | 35/35 |
| Min. Bohrloch Durchmesser (mm) | 0,15 | 0.10 | 0,15 | 0.10 | 0,15 | 0.10 |
| Seitenverhältnis von PTH | 14: 1 | 16: 1 | 16: 1 | 18: 1 | 18: 1 | 20: 1 |
| N + C + N | 4 + C + 4 | 5 + C + 5 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 |
| Irgendeine Schichtverbindung | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 |
| Plattenfüllung via | JA | - | JA | - | JA | - |
| Mindest. Kerndicke (ohne Kupfer) (µm) | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
| Mindest. Laser Bohrdurchmesser (µm) | 75 | 65 | 65 | 50 | 50 | 40 |
| Via auf begraben Loch / gestapelt über | JA | - | JA | - | JA | - |
| Material | FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Schweres Kupfer, usw. | | | | | |
| Eingebettete Kondensator-Leiterplatte | JA | - | JA | - | JA | - |
| Oberflächenprozess | Bleifrei HASL, ENIG, OSP, Immersion Silber, Eintauchzinn, Flash-Gold, Gold-Finger-Beschichtung, selektive Hartvergoldung, Peelable Lötmaske, Kohlenstofftinte | | | | | |

Bare Leiterplatte Unternehmen, Waschmaschine Platine